



応用物理学会 薄膜・表面物理分科会主催

協力応用物理学会分科会・研究会：応用電子物性分科会，フォトニクス分科会，シリコンテクノロジー分科会，結晶工学分科会，次世代リソグラフィ技術研究会，集積化MEMS技術研究会，固体量子センサ研究会
協賛学会：日本物理学会，日本化学会，日本表面真空学会，電子情報通信学会，電気学会，日本結晶学会，日本結晶成長学会，日本磁気学会，表面技術協会，日本材料学会，表面分析研究会，日本セラミックス協会，日本放射光学会，ナノ学会，精密工学会
後援：北陸先端科学技術大学院大学

第52回 薄膜・表面物理セミナー（2024） 先端集積回路の技術動向と光機能融合技術

集積回路市場は急速に成長しており、世界的な需要増加に対応するための製造能力の拡大が急務となっています。COVID-19の影響でサプライチェーンに大きな混乱が生じましたが、アジア太平洋地域を中心に急成長が見込まれ続けており、工場の新設や投資が相次ぎ、技術競争が激化しています。本セミナーでは、重要な社会基盤である集積回路技術の最新の動向を講演いただくとともに、集積回路性能のさらなる向上のアプローチとして期待される光機能融合技術について薄膜・表面技術との関連にも着目しながら講演をいただきます。

日時：2024年7月4日（木）13:00-16:45
場所：北陸先端科学技術大学院大学 東京サテライト
研修室C, D, E（ハイブリッド開催）

現在非会員の方でも、参加登録時に薄膜・表面物理分科会（年会費正会員：2,200円、準会員：3,000円）にご入会いただければ、本セミナーより会員扱いとさせていただきます。
<https://www.jsap.or.jp/>より入会登録を行い、会費支払及び仮会員番号を取得後、本セミナーにお申込み下さい。（年会費をセミナー参加費と同時に振込なさらないで下さい。）

1. プログラム：（敬称略）

日時	講演テーマ	講師
13:00~13:05	開会	
13:05~13:55	最先端ロジックプロセス技術の最新動向	山本知成 (東京エレクトロン)
13:55~14:45	ナノスケールトランジスタの課題	内田建 (東大)
14:45~15:00	休憩	
15:00~15:50	フォトニクス応用に向けたIV族混晶ヘテロ構造の結晶成長技術	中塚理 (名大)
15:50~16:40	シリコンフォトニクス最新動向	竹中充 (東大)
16:40~16:45	閉会	

2. 参加費：テキスト代、消費税を含む。

薄膜・表面物理分科会会員*	応用物理学会会員** ・協賛学協会会員	学生	その他
7,000円	10,000円	0円	17,000円

*薄膜・表面物理分科会賛助会社の方は分科会会員扱いといたします。
**応用物理学会賛助会社の方は、応用物理学会会員扱いといたします。

3. 参加申込期間：

2024年4月29日(月)~6月28日(金)

4. 参加申込方法：下記URLあるいはQRコードからイベントペイのサイトにアクセスし、参加登録してください。

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=1804158131583761&EventCode=0053570503

コンビニ支払い、ページー決済可。
原則として、参加費の払い戻し、請求書の発行はできません。
領収書は申し込みサイトからダウンロード可能です。



5. 参加費支払期限：2024年7月1日(月)

6. 企画に関する問合せ先：

九州大学 佐道泰造
E-Mail: sadoh@ed.kyushu-u.ac.jp
(株)ダイセル/金沢大学 吉川太郎
E-Mail: tr.yoshikawa@jp.daicel.com

7. 参加登録問合せ先：

応用物理学会事務局分科会担当 岡本晋一
TEL: 03-3828-7723
E-Mail: divisions@jsap.or.jp